

効果

- ・ 1180MPa材を980MPa材並の荷重で成形可能
- ・ 適用例：Aピラー、Bピラー

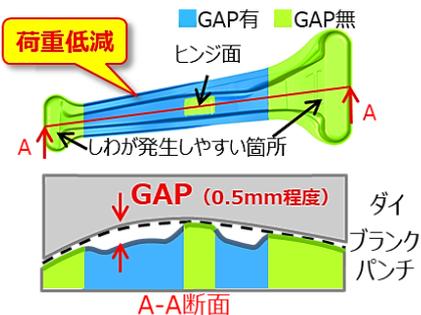
ポイント

コンセプト

パンチの特定部位にGAP(金型クリアランス:板厚+a)を施すことで、しわの押し潰しによる急激な荷重増加を低減

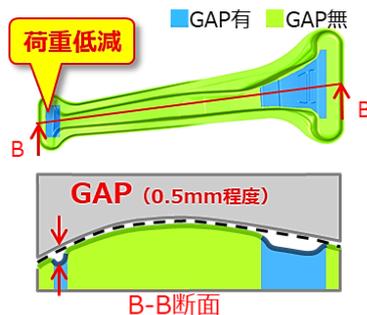
【1工程目 ドロー】

・しわのない部位にGAPを施す。



【2工程目 フォーム】

・1工程目で成形した箇所へGAPを施す。



適用事例

Bピラー上部のT字部を単純化したラボ金型による検証では、しわや寸法精度の悪化を防ぎつつ、成形荷重を10%以上の低減を確認（Bピラー上部、下部をあわせると20%の低減が可能）

